

ICS 31.180
L 30



中华人民共和国国家标准

GB/T 4588.12—2000
idt IEC 60326-12:1992

预制内层层压板规范 (半制成多层印制板)

Specification for mass lamination panels
(semi-manufactured multilayer printed boards)

2000-12-11 发布

2001-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

前言	I
IEC 前言	II
IEC 引言	II
1 范围	1
2 引用标准	1
3 总则	1
4 技术说明文件	2
5 预制内层层压板特性	3
6 包装	4
附录 A(标准的附录) 有关详细规范	6

前 言

本标准等同采用 IEC 60326-12:1992《预制内层层压板(半制成多层印制板)》。

本标准涉及的预制内层层压板这一产品已在国际印制板产业中广泛使用,它是多层印制板的半制成品,其主要特点是生产量大,成本低廉,特别适用于品种少,批量大的多层印制板。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国印制电路标准化技术委员会归口。

本标准由华北计算技术研究所负责起草。

本标准主要起草人:柴永茂、张春婷、刘筠。

IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际上的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准。IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指出。

本标准由 IEC 第 52 技术委员会(印制电路)制定。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告
52(CO)367	52(CO)382

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

附录 A 的内容仅是提供的信息。

IEC 引言

IEC 60326 涉及准备安装元件的印制板,而不考虑它们的制作方法。

本标准分为几个独立的部分,包括设计者用的信息,供规范制定者用的建议以及各种类型印制板(如单面、双面、多层及挠性印制板)的试验方法和要求。

中华人民共和国国家标准

预制内层层压板规范 (半制成多层印制板)

GB/T 4588.12—2000
idt IEC 60326-12:1992

Specification for mass lamination panels
(semi-manufactured multilayer printed boards)

1 范围

本标准适用于预制内层层压板,它规定了预制内层层压板的特性,与其制造方法无关,其目的在于作为供需双方签定协议的基础。本标准中使用的“有关规范”这一术语指的就是这些协议。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 12629—1990 限定燃烧性的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板(制造多层印制板用)
(idt IEC 60249-2-12:1987)
- GB/T 4588.3—1988 印制电路板设计和使用(neq IEC 60326-3:1980)
- GB/T 4588.4—1996 多层印制板分规范(idt IEC/PQC 91:1990)
- GB/T 18334—2001 有贯穿连接的挠性多层印制板规范(idt IEC 60326-9:1991)
- GB/T 18335—2001 有贯穿连接的刚挠多层印制板规范(idt IEC 60326-11:1991)
- SJ/T 10723—1996 印制板辅助标准——第3部分:照相制版指南(neq IEC 60321-3:1990)
- IEC 60326-2:1990 印制板——第2部分:测试方法

3 总则

3.1 预制内层层压板

印制板是由最终用户使用的制成单块的印制线路。由一块或多块印制板组成的预制内层层压板是从预制内层层压板厂订购的成品。预制内层层压板厂具有大量生产多层板的在制板的能力,从而节省成本。本标准指的就是这种在制板。

预制内层层压板是多层印制板的中间生产阶段。在这一阶段,已经加工完内层,并且导电层和绝缘层交替层压成在制板。两个外层导体层不由预制内层层压板厂加工,而由订购方进行钻孔和其他加工。

预制内层层压板是用来制做多层印制板的半成品。因此:

——它们是根据订购方提供的数据蚀刻的、精确重合的内导体层、绝缘层,以及绝缘层两个外层没有蚀刻覆铜箔层的、由一块或几块印制板和绝缘层构成的在制板。

——它们是由一叠单面或双面蚀刻的覆铜箔基材、预浸材料以及铜箔层压而成的。

——它们包括一个定位体系,该体系保证在与内层导体层精确重合的情况进行钻孔。

——它们可能已经在内导体层间互连(埋孔),但与外导体层没有互连。

3.2 构制预制内层层压板